

证券代码：300476

证券简称：胜宏科技

胜宏科技(惠州)股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国金证券、广发基金、富国基金、兴全基金、南方基金、招银理财、重阳资产、大椿基金、博时基金、歌汝资产、诺德基金、摩根士丹利、金鹰基金、中欧基金、国联基金、富荣基金、望正资产、前海开源基金、建信保险资管、华杉投资、华泰柏瑞基金等 40 位机构投资者
时间	2026年05月07日-2026年05月08日
地点	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技（惠州）股份有限公司
上市公司接待人员姓名	1、董事长：陈涛 2、董事、总裁：赵启祥 3、副总裁、董事会秘书：朱溪瑶
投资者关系活动主要内容介绍	一、投资者参观公司展厅、生产车间 二、公司发展情况介绍 公司坚定“拥抱 AI，奔向未来”，精准把握 AI 算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，持续巩固在全球 PCB 制造领域的技术领先地位。在 AI 算力、数据中心、高性能计算等关键领域，多款高端产品已实现大规模量产，带动产品结构向高价值量、高技术复杂度方向升级，高端产品占比显著提升，推动公司业绩高速增长。

三、互动交流环节具体情况如下：

1、公司年报和一季报显示经营现金流状况非常好，业务上客户和产品也有许多变化。请问第二季度关键产品的进度如何？

答：目前公司在手订单饱满，业务进展顺利，订单生产和交付均在正常履行中。公司目前在大客户和 ASIC 客户新产品、新技术方面的布局进展顺利，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期，建立技术壁垒。

公司与客户保持密切沟通，根据客户需求推进产能准备工作，全力配合新产品的研发及量产工作。具体产品的量产时间节点将结合技术研发进度与客户需求综合确定。

2、目前北美科技厂商有LPU大配套的趋势，相应的产品会在第二季度有相对不错的贡献吗？

答：公司目前在客户新产品、新技术方面的布局进展顺利。随着新产品层数增加、板厚增厚、材料等级提高等技术变化，对 PCB 制造工艺要求大幅提高，部分工序的加工时间更长、复杂度更高，加大了对公司高端产能的消耗。

公司与客户保持密切沟通，根据客户需求推进产能准备工作，全力配合新产品的研发及量产工作。具体产品的量产时间节点将结合技术研发进度与客户需求综合确定。

3、大客户现在单一占比较高，未来是否会通过导入更多 ASIC客户来平衡单一客户的财务风险？

答：公司持续加大市场攻坚与客户拓展力度，坚守“高

端化、多元化”的布局原则，丰富客户结构，深度贴近客户需求，凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，公司参与了目前市场上大部分主流玩家的新方案。

公司将巩固现有核心客户合作基础，深化与科技巨头的战略合作，持续扩大 GPU 加速卡、TPU 配套板等核心产品供应规模。目前公司在 ASIC 相关客户的业务进展顺利，未来有望成为公司业绩增长的核心动力之一。

4、上游原材料紧缺情况下，公司是否受影响？上游材料如何保供？公司如何应对原材料涨价？

答:公司对生产所需的关键原材料进行了积极的策略性备货和安全库存管理。作为多家关键原材料供应商的第一大客户，公司与主要原材料供应商均已建立了稳定的战略合作关系，原材料供应稳定。

原材料成本是公司产品定价的重要影响因素之一，针对原材料价格波动的潜在风险，公司一方面会结合原材料价格走势与下游客户协商产品定价，合理传导成本压力；另一方面，公司将通过技术工艺创新、供应链战略合作深化等方式，持续对冲原材料价格波动带来的影响。

目前公司高端产品所需主要原材料价格相对稳定，已量产的高端产品价格也较为稳定，新产品将结合原材料价格走势及 PCB 工艺技术难度，与客户协商定价。

5、公司订单及产能利用率情况怎么样？

答：当前公司在手订单饱满，惠州工厂产能利用率维持在较高水平。

公司正在全力以赴推进扩产，稳步推进 2030 年千亿

	<p>产值目标落地。当前各环节进度顺利，公司扩产速度已处于行业领先水平。新建厂房需经历厂房建设装修、设备安装调试、客户审厂、送样测试、订单下达及量增等阶段，公司与客户保持密切沟通，根据客户需求推进产能准备工作，初期的产线磨合和产能产量逐步释放是行业的必经过程，公司对后续的生产经营及效益实现充满信心。</p> <p>6、公司对mSAP的产能规划情况是怎样的？</p> <p>答：公司在惠州配置了 mSAP 车间，该产能目前用于满足 1.6T 光模块的生产需求，产能利用率处于良好水平。</p> <p>此外，公司正积极推进 CoWop 技术的研发及生产工作，该技术需同时具备高阶 HDI 和 mSAP 工艺能力，预计相关 PCB 产品价值量将有较大幅度提升。公司始终与客户保持密切沟通，根据客户需求推进产能准备工作，全力配合新产品的研发及量产工作。</p> <p>7、未来大客户新产品单板的价值量大致如何？</p> <p>答：未来高端 PCB 产品的技术发展路线是不断降低单位算力能耗、提升算力密度和电性能能力，具体体现为：信号传输带宽持续升级，材料等级不断提高；高多层板、高阶 HDI 的层数、阶数不断增加，板厚进一步增厚，电路密度也更精细。这种变化导致 PCB 制造工艺要求大幅提高，加大了对产能的消耗，同时也使得产值提升，ASP 发生成倍甚至呈指数级别的增长。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年05月08日</p>